各　位

平成 24 年 2 月 29 日

会　社　名　　日本電子材料株式会社
代　表　者　　代表取締役社長　風間　悦男
（コード番号　6855　東証１部）
問合せ先　　取締役　管理部門統括部長　足立　安孝
電　　話　　０６（６４８２）２００７

債権の取立不能又は取立遅延のおそれに関するお知らせ

当社は、平成 24 年 2 月 27 日付で、エルピーダメモリ株式会社が、会社更生手続開始の申立てを行ったことに伴い、同社に対する債権について、以下のとおり、取立不能または取立遅延のおそれが生じましたので、お知らせします。

記

1. 相手方の概要

(1)名称	エルピーダメモリ株式会社	
(2)本店所在地	東京都中央区八重洲二丁目 2 番 1 号	
(3)代表者の役職・氏名	代表取締役社長兼 CEO 坂本 幸雄	
(4)事業内容	半導体素子、集積回路等の電子部品の開発、設計、製造、販売 および保守など	
(5)資本金	2,361 億円(平成 23 年 9 月 30 日現在)	
(6)設立年月日	平成 11 年 12 月 20 日	
(7)純資産	2,736 億円(平成 23 年 3 月 31 日現在)	
(8)総資産	7,216 億円(平成 23 年 3 月 31 日現在)	
(9)大株主及び持株比率	(平成 23 年 9 月 30 日現在) みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託　日立製作所口 再信託受託者　資産管理サービス信託銀行株式会社　4.66% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　3.62% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）　3.42%	
(10)上場会社と当該会社との関係等	資本関係	該当事項はありません
	人的関係	該当事項はありません
	取引関係	当社による同社社債、 および売掛債権の保有
	該当当事者への該当状況	該当事項はありません

２.当該取引先に生じた事実

平成24年２月27日付で、東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行ったことに伴うものであります。

３．当該取引先に対する債権の種類及び金額（平成 24 年２月 27 日現在）

社債	100 百万円
売掛債権	4 百万円
合計	104 百万円
純資産に対する割合	直近事業年度の末日（平成 23 年 3 月 31 日）の連結純資産（9,174 百万円）に対する割合　1.1％

４．当該事実が当社の業績に及ぼす影響

平成 24 年 3 月期の業績への影響につきましては現在精査中であり、その影響が確定次第、開示いたします。

以上